
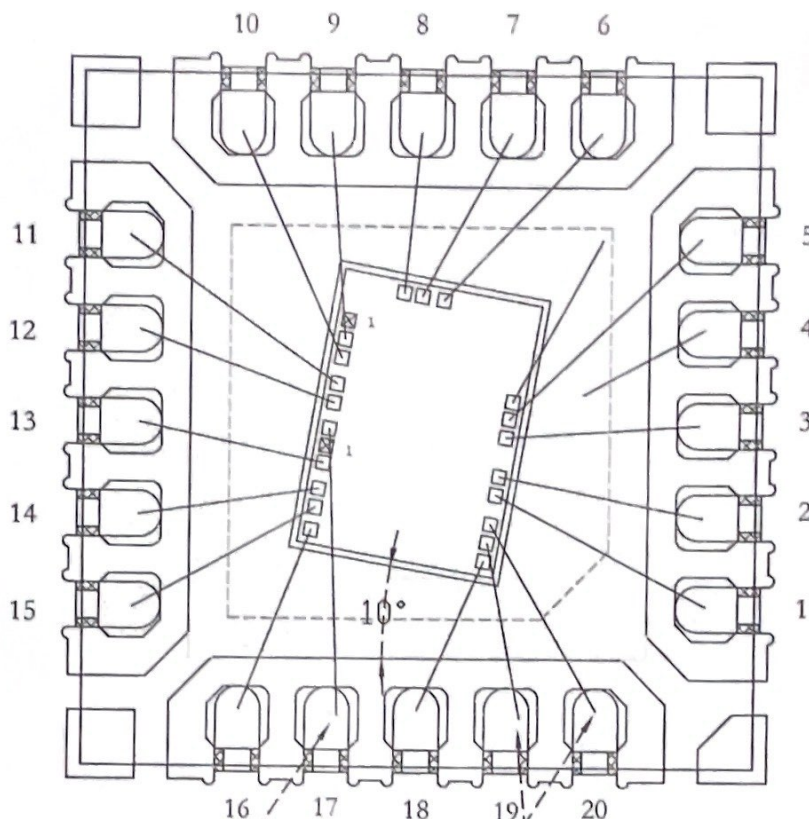


<div></div> <div>池州华宇电子科技股份有限公司</div> <div>CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD</div> <div>焊线图纸 Bonding Diagram</div>				客户代码 Customer No.	008	线型号 Drawing No.	HY-PX-008-758 A	
				产品名称 Product Type	HS16F3612TM		封装类型 PKG Type	QFN20L(3X3X0.5-P0.4)
焊线种类 Wire Type	焊线直径 Wire Diameter	焊线数量 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑料封装(绿色环保) Compound Type: (Green)		L/F 封装尺寸 L/F Pad Size
合金 Ag	20	21	23664	1252	609	可选(Preference): CEL-9220H (F) 可选(Optional): BME-G770H (D)		QFN20L(3X3X0.5-P0.4) (81X81mm ² /4block) (2M6X2mm ²)
客户图号 Customer drawing NO.								



注意使用J线弧 注意使用J线弧

封装传递方向 (载片):
L/F Direction (D/A):

椭圆孔



引脚图:
Chip photo:

特殊说明 Special Instructions:

DB注意:
1. 芯片居中放置并顺时针旋转10°;
2. 控制温度, 为WB预留焊线位置;

WB注意:
1. 数字为不打线pad点个数;

说明 Instruction	贴片胶类型 epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPP (μm ²)	最小焊盘间距 Min BPP (μm)	焊盘厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	贴片线宽 Stress line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否兼容 Low-A Die Size A	晶圆厚度 Wafer Thickness
A芯: DIE A	导电胶 (conductive) S220	HS5137	1200*890(μm ²) 47.24*35.04(mm ²)	60*60	82	0.8	是/Yes	60	8	否/NO	160
B芯: DIE B											
C芯: DIE C											
编制 Prepared by	李林 2024.4.27		制图日期 Create Date	2024/4/27		生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: Customer Signature				
研发审核 R&D Check	李林 2024.4.27		产品工程审核 PE Check			批准 Approved by	李林 2024.4.28				

温馨提示: 出图后产品下线生产前请确认, 如有疑问请及时反馈, 以便及时修正, 避免因误读造成生产损失, 谢谢!
Warm tip: the drawing is the only basis for the production of the product. Please confirm it carefully. Our company will produce the drawings according to the drawings you have signed back, such as drawing mistakes, which will produce inevitable loss. Thank you!